

JLCPCB Capabilities

PCB

導体層数	1層 - 20層
最大基板サイズ	400mm × 500mm
寸法公差	±0.1mm
基板厚	0.4mm - 2.5mm
基板厚寸法公差	±基板厚10%

最小配線

配線-配線	0.127mm (1層・2層)
	0.09mm (4層以上)
配線幅	0.127mm (1層・2層)
	0.09mm (4層以上)

ドリル・穴サイズ

ドリル穴径	0.3mm - 6.3mm
ドリル穴径公差	+0.13mm / -0.08mm
外層-内層ビア	×
内層-内層ビア	×
最小ビア直径	0.5mm (1層・2層)
	0.3mm (4層以上)
最小ビア穴径	0.3mm (1層・2層)
	0.2mm (4層以上)
導体穴径	0.2mm - 6.35mm

最小マージン

穴-穴	0.5mm (異ネット)
ビア-ビア	0.254mm (同ネット)
パッド-パッド	0.127mm (異ネット)
ビア-配線	0.254mm
導体穴-配線	0.33mm
非導体穴-配線	0.254mm
導体-配線	0.2mm